

2018年3月期 第2四半期（2017年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2017年10月31日

内容：

- 第2四半期連結決算の概要 代表取締役・CFO、専務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第2四半期 連結決算の概要

2017年10月31日

堀 哲朗

代表取締役・CFO、専務執行役員



FY2018 Q2 (2017年7月~9月) ハイライト

- 売上は過去最高の2,805億円 (前四半期比+19%)
 - SPE新規装置の売上の6割がメモリ向け
 - FS事業の売上は+18%の644億円
- 順調に利益率が向上
 - 営業利益率は過去最高の24.4% (前四半期比+1.2pts)
 - FPDセグメント利益率は想定通り改善
- 旺盛な半導体需要を背景に、通期売上・利益計画を上方修正

SPE : 半導体製造装置、FS : フィールドソリューション、FPD : フラットパネルディスプレイ製造装置

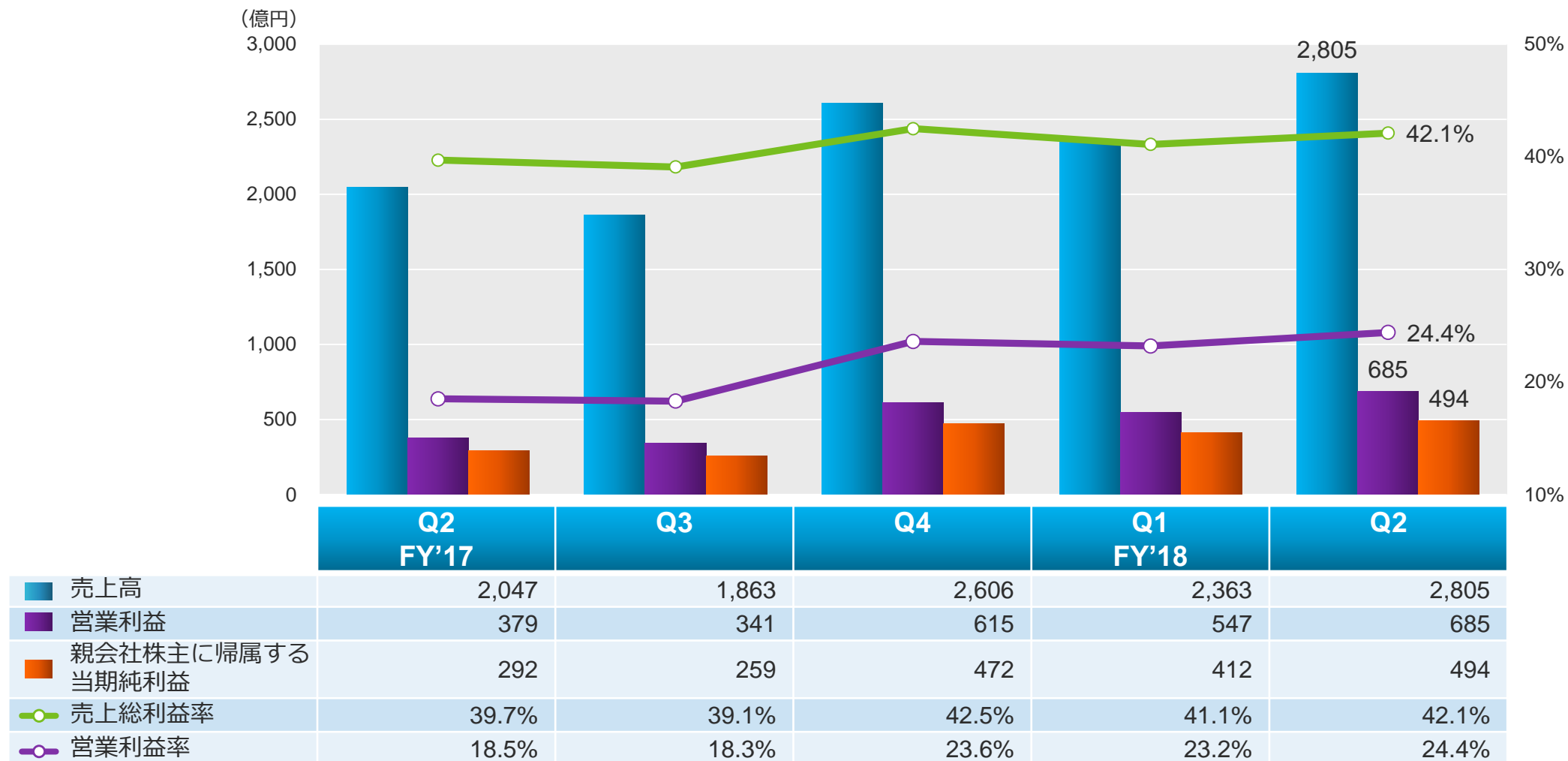
損益状況

(億円)

	FY2017			FY2018		対Q1 増減率
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
売上高	2,047	1,863	2,606	2,363	2,805	+18.7%
売上総利益 下段：売上総利益率	813 39.7%	729 39.1%	1,106 42.5%	971 41.1%	1,182 42.1%	+21.7% +1.0pts
販管費	434	387	491	423	497	+17.4%
営業利益 下段：営業利益率	379 18.5%	341 18.3%	615 23.6%	547 23.2%	685 24.4%	+25.1% +1.2pts
税前利益	382	332	614	551	671	+21.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	292	259	472	412	494	+19.8%
研究開発費	220	191	248	211	248	+17.4%
設備投資額	55	41	71	81	117	+44.0%
減価償却費	42	45	50	42	47	+12.7%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

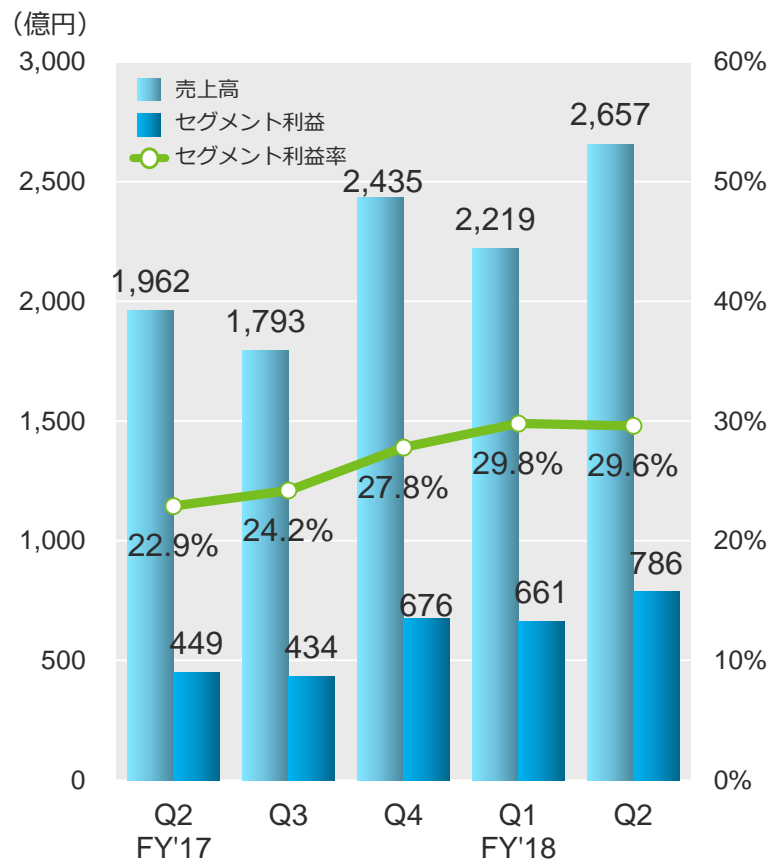
損益状況



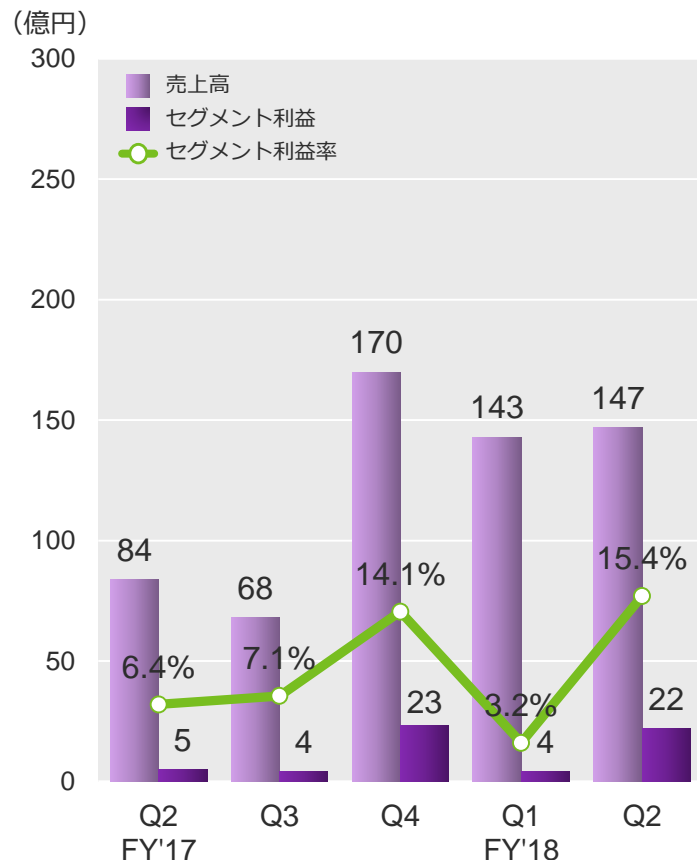
売上総利益率は高水準を維持、営業利益率は過去最高

セグメント情報

SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



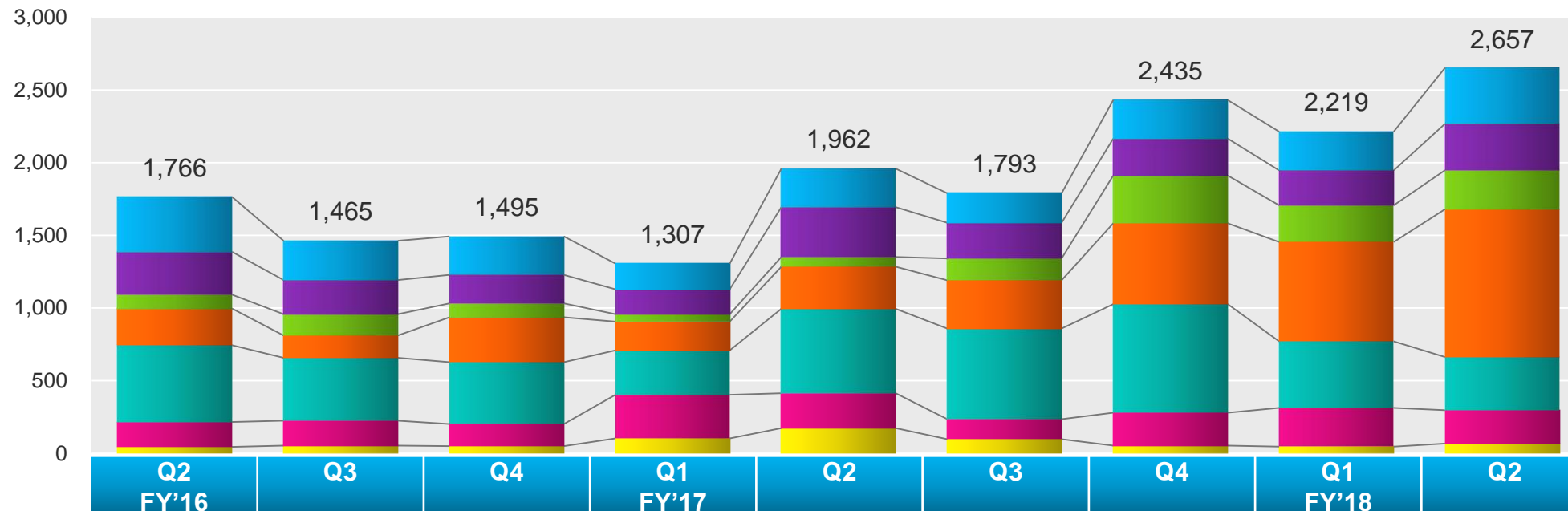
売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

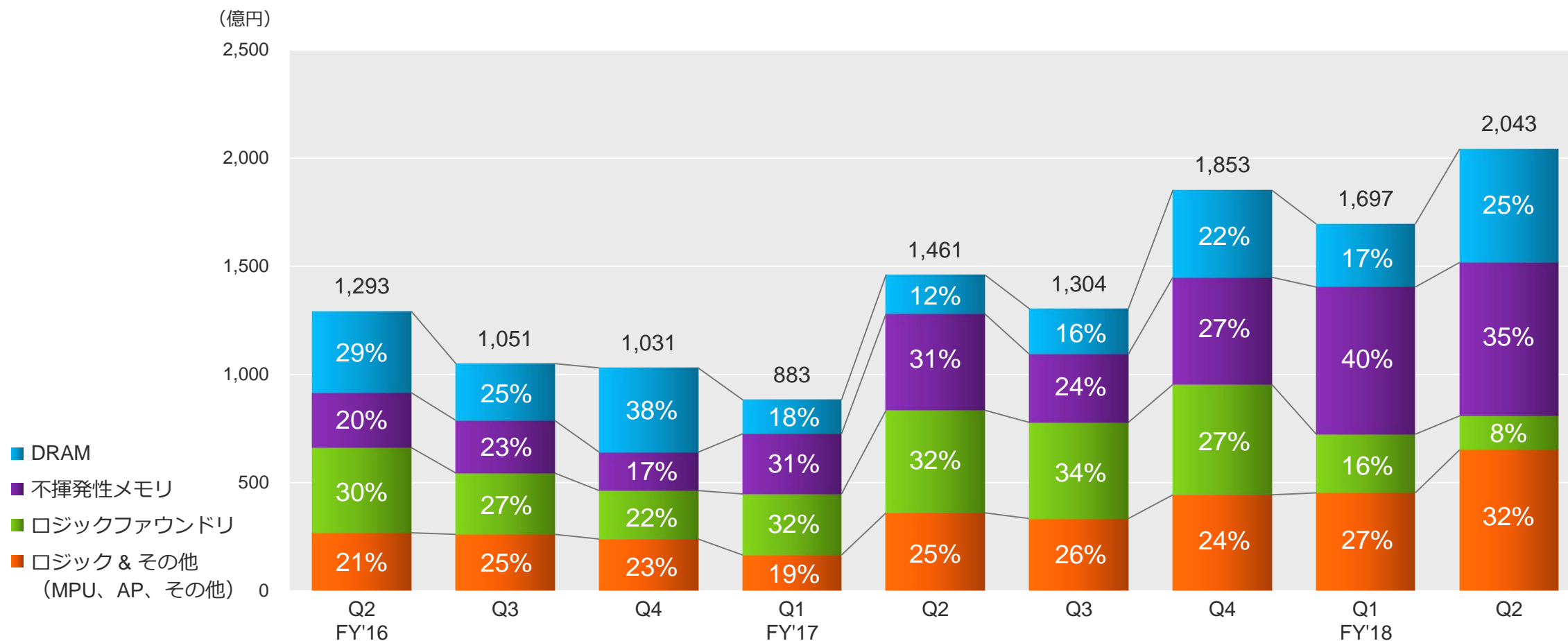
SPE部門 地域別売上高

(億円)



■ 日本	378	270	264	178	264	203	266	267	384
■ 北米	294	234	197	170	344	246	254	240	320
■ 欧州	96	148	95	52	66	150	329	253	269
■ 韓国	252	152	309	198	290	333	555	683	1,017
■ 台湾	529	433	425	305	582	623	747	458	366
■ 中国	170	172	152	300	240	137	227	267	230
■ 東南アジア・他	45	53	50	103	173	98	53	46	67

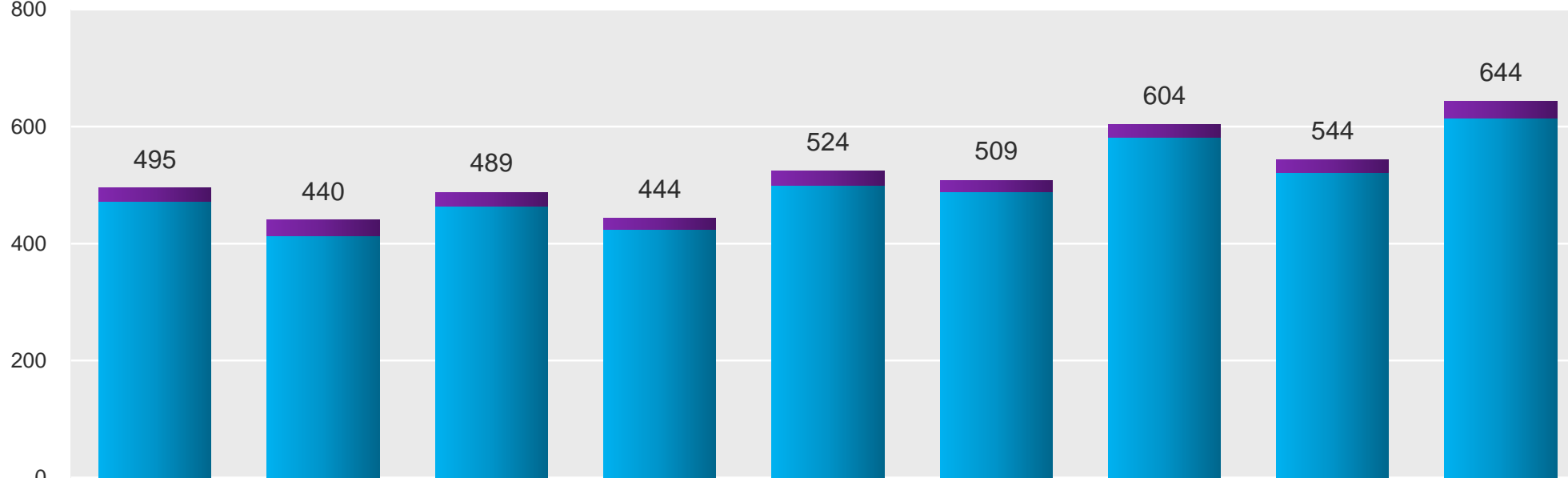
SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



韓国・台湾のDRAMおよび韓国・米国のロジック向けが増加
台湾のファウンドリが減少

フィールドソリューション売上高

(億円)

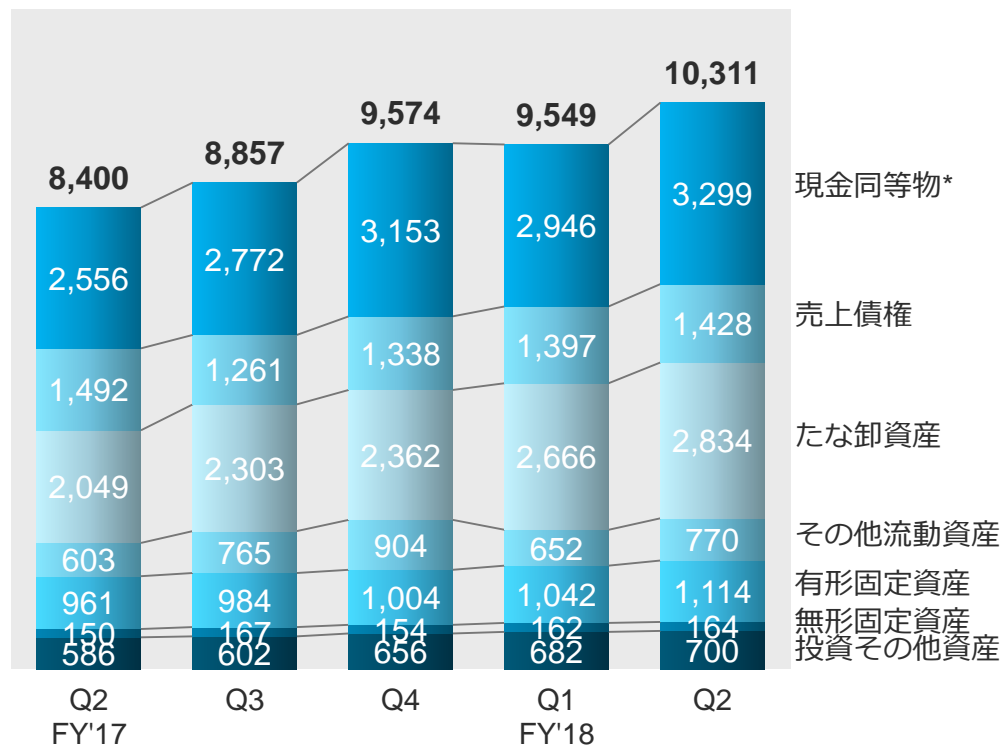


	Q2 FY'16	Q3	Q4	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2
SPE売上高	472	413	464	424	500	488	581	522	614
FPD売上高	23	27	24	20	24	20	22	22	29

貸借対照表

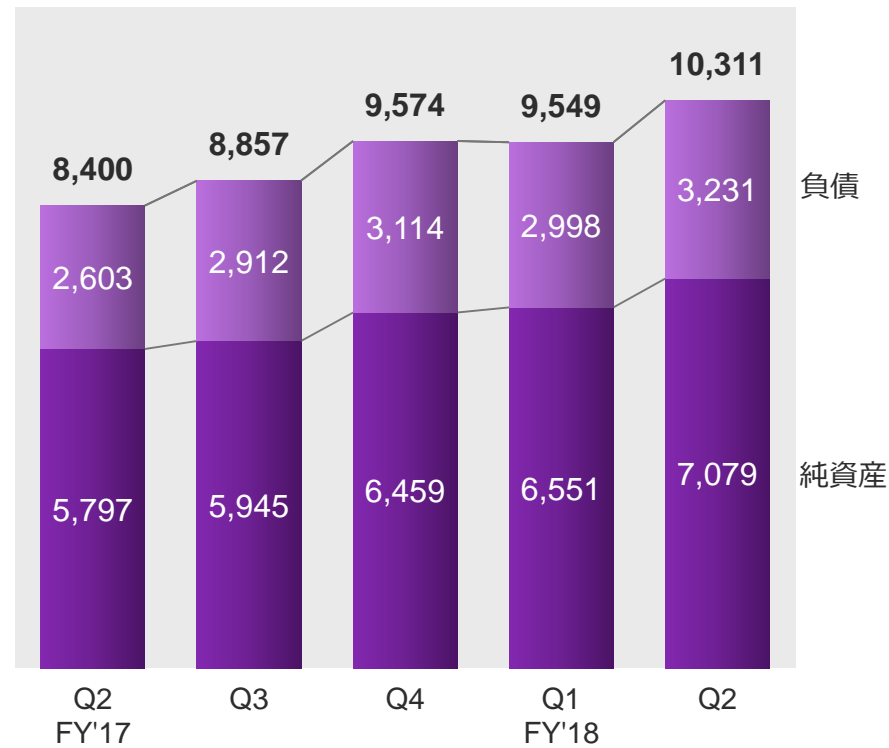
資産

(億円)



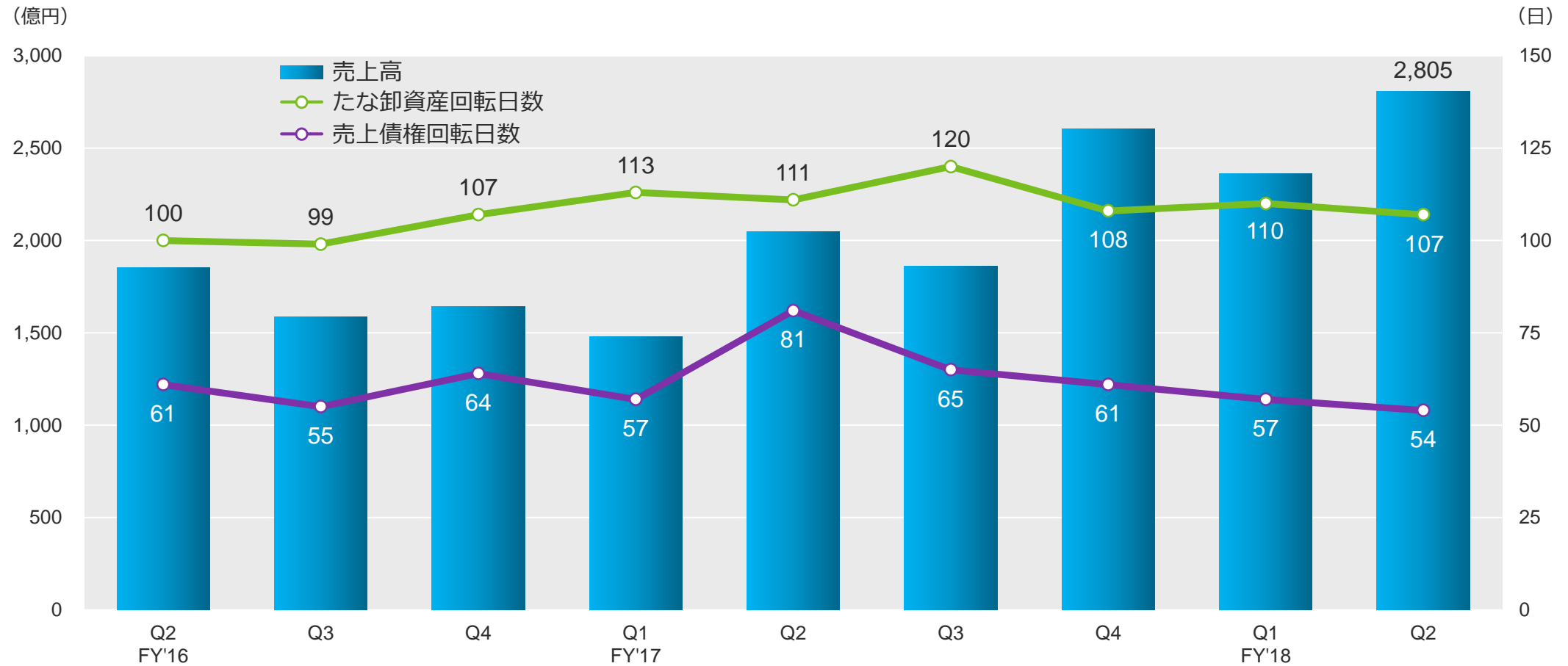
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

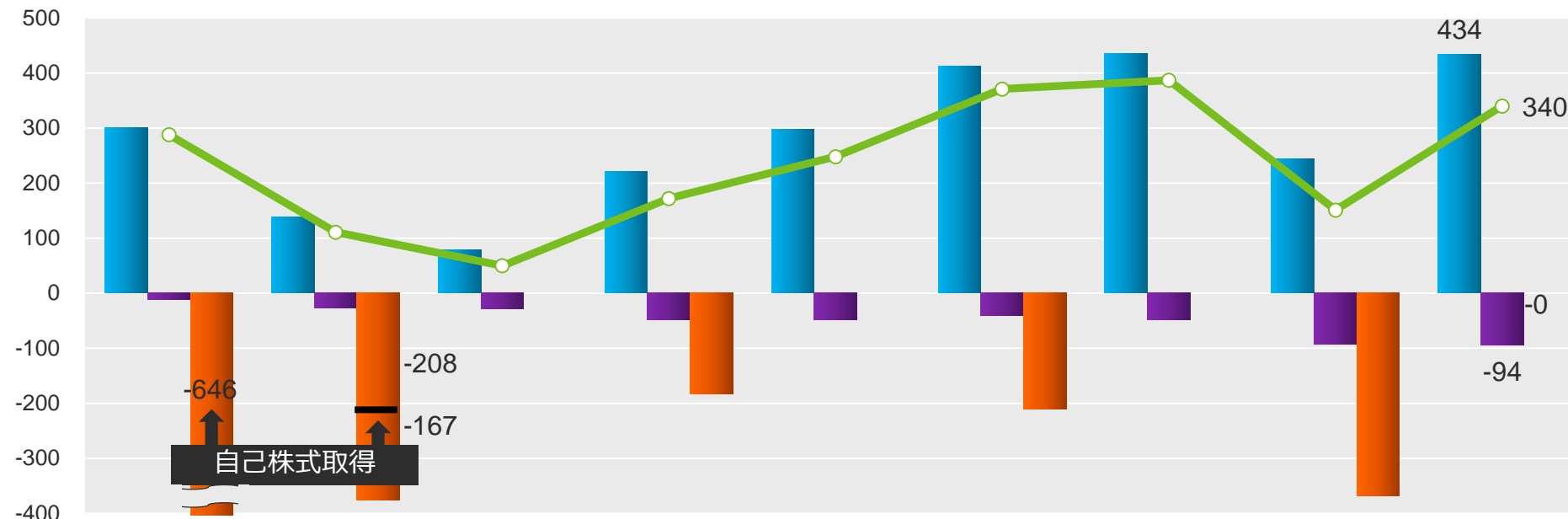
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	Q2 FY'16	Q3	Q4	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2
■ 営業キャッシュ・フロー	301	138	79	221	298	413	436	244	434
■ 投資キャッシュ・フロー*	-12	-27	-29	-49	-49	-41	-49	-93	-94
■ 財務キャッシュ・フロー	-646	-375	0	-183	0	-210	-0	-368	-0
● フリーキャッシュ・フロー**	288	111	50	172	248	371	387	151	340
手元資金残高***	2,607	2,338	2,366	2,309	2,556	2,772	3,153	2,946	3,299

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

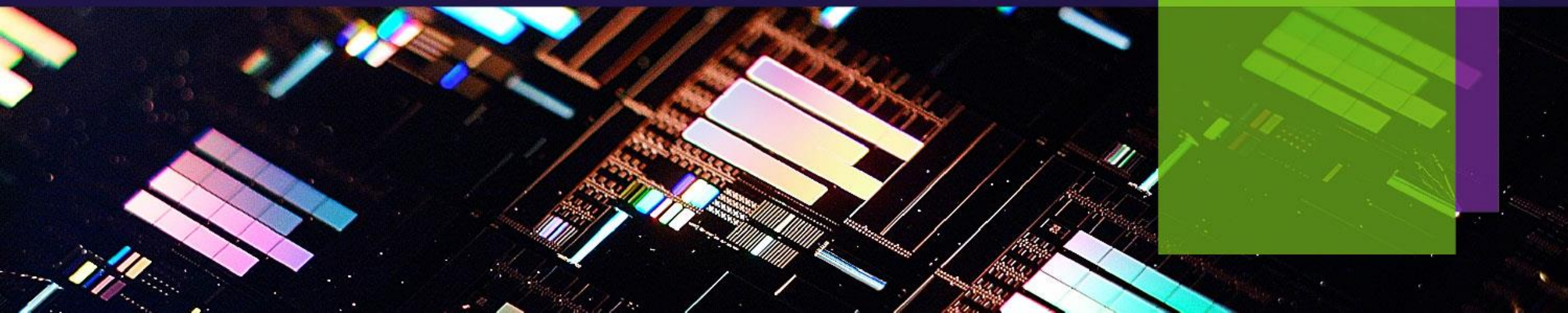
** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

事業環境および業績予想修正

2017年10月31日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

将来の成長ドライバー

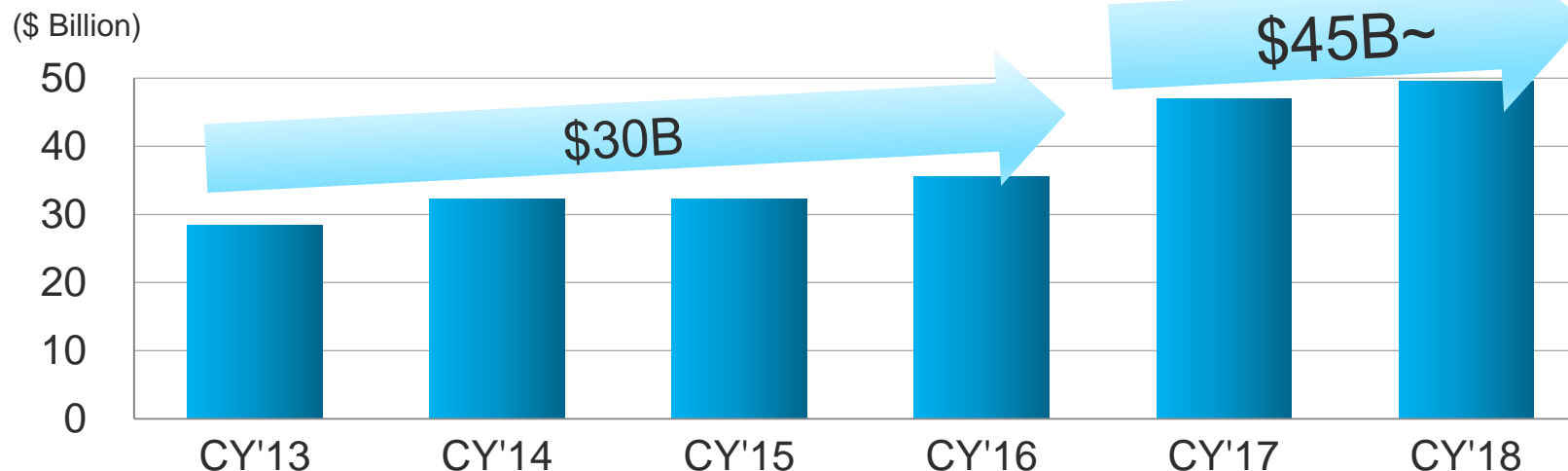
PC・インターネット・モバイル
+
VR/AR*・IoT・AI**・機械学習
ビッグデータ・自動運転・個別化医療

* VR/AR : 仮想現実/拡張現実 ** AI : 人工知能

WFE市場の成長加速

\$45B以上の投資継続

先端ロジック・メモリ向けともに
投資拡大



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

事業環境（2017年10月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)* の設備投資

CY2017の投資額は、旺盛な3D NANDおよびDRAM向け需要に牽引され、前年比25%程度の成長を見込む。CY2018については、CY2017と同等以上の投資継続を予想。

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程** 向け設備投資

CY2017の装置需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む。CY2018については、第10.5世代向けの投資拡大により、さらに20%以上の成長を予想。

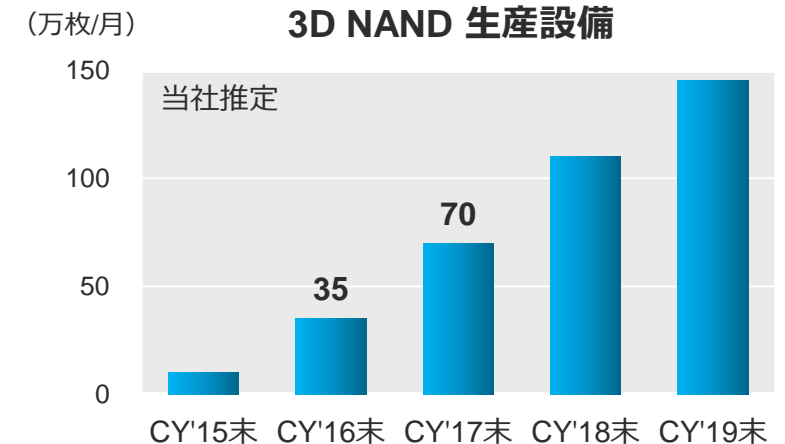
装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

** TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

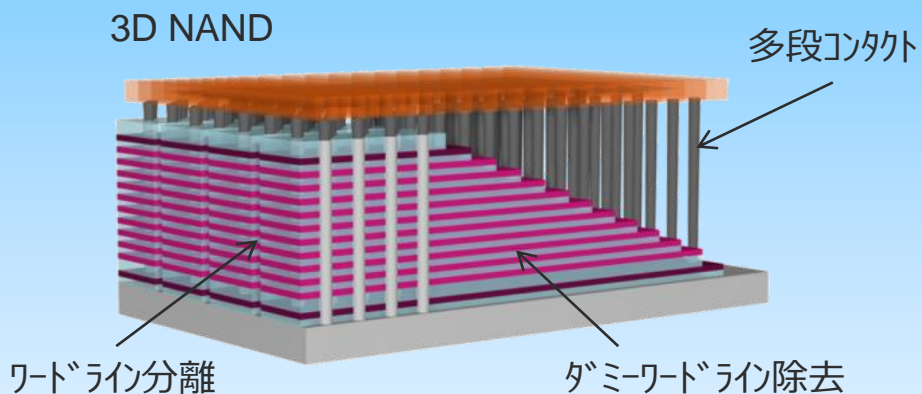
CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

- NAND：前年比50%の市場成長を予想
 - 設備投資：最先端の6X/7X世代向けが7割
 - 牽引役：データセンタ向けSSD需要の拡大
 - 事業機会：高付加価値のエッチング工程で差別化
- DRAM：50%の増加
 - 設備投資：1Xnm世代向け設備投資が6割
 - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比25%増加、サーバも40%増加
 - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準を予想
 - 設備投資：10/7nm世代向けが7割
 - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大



FY2018 SPE事業の進捗

- CY2017は注力3装置分野（エッチング、成膜、洗浄）のシェア向上を見込む
 - 次世代技術に対応した高付加価値製品で差別化
- 投資拡大とシェア向上により、メモリ向け通期売上予定が前期比2倍
 - エッチング装置（3D NAND: 多段コンタクト/ワードライン分離、DRAM: パターニング/配線工程等）
 - 成膜装置（3D NAND: メモリホール多層膜）
 - 洗浄装置（3D NAND: ダミーワードライン除去、DRAM: メタル除去洗浄等）
 - マルチセルテストシステム（3D NAND向け高速テスト）



プラズマエッチング装置
Tactras™



ALD装置
NT333™



バッチ洗浄装置
EXPEDIUS™-i

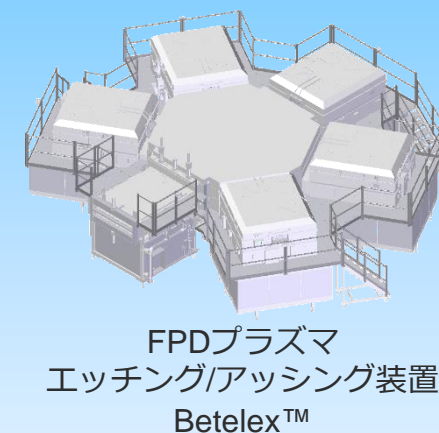
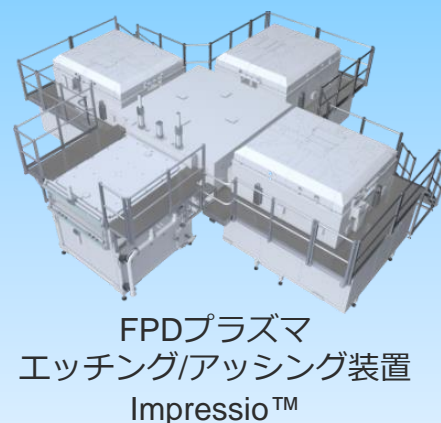
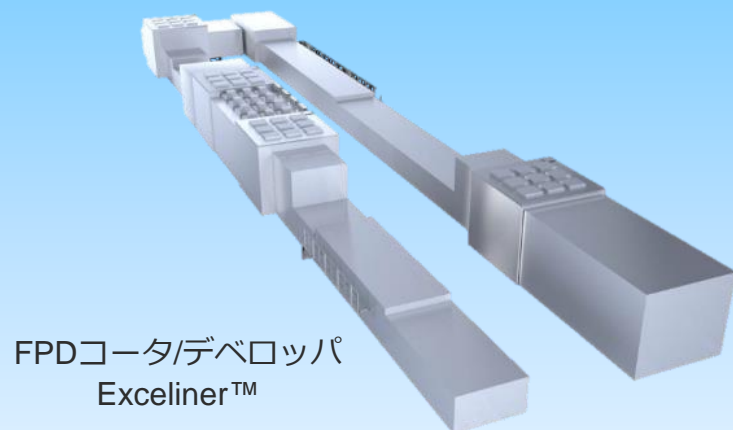


マルチセルテストシステム
Cellcia™

SPEの事業戦略は計画通り進捗、次世代向け技術でシェア拡大

FY2018 FPD事業の進捗

- 第10.5世代におけるリーディングポジション確立
- 新プラットフォーム エッチング装置 Betelex™を投入
- PICP™*エッチング装置の製品展開が好調
 - 中小型向け通期売上予定が前期比約2倍、大型向けにもビジネス獲得



FPDの事業戦略は順調に進捗、計画通りの利益率向上を見込む

FY2018 業績予想修正

FY2018 業績予想修正

(億円)

	FY2017 (実績)	FY2018 (予想)					
		H1	H2		通期		通期 対前年増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	7,997	5,169	6,130	+1,130	11,300	+1,500	+41.3%
SPE	7,498	4,877	5,670	+1,080	10,547	+1,447	+40.6%
FPD	493	290	459	+49	750	+50	+51.9%
売上総利益 下段：売上総利益率	3,222 40.3%	2,154 41.7%	2,515 41.0%	+415 -1.0pts	4,670 41.3%	+550 -0.7pts	+1,447 +1.0pts
販管費	1,665	920	1,039	+59	1,960	+0	+294
営業利益 下段：営業利益率	1,556 19.5%	1,233 23.9%	1,476 24.1%	+356 +1.7pts	2,710 24.0%	+550 +2.0pts	+1,153 +4.5pts
税前利益	1,491	1,223	1,447	+327	2,670	+510	+1,178
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	906	1,073	+233	1,980	+350	+827
1株当たり当期純利益 (円)	702.26	552.59	654.13	+142.17	1,206.73	+213.29	+504.47

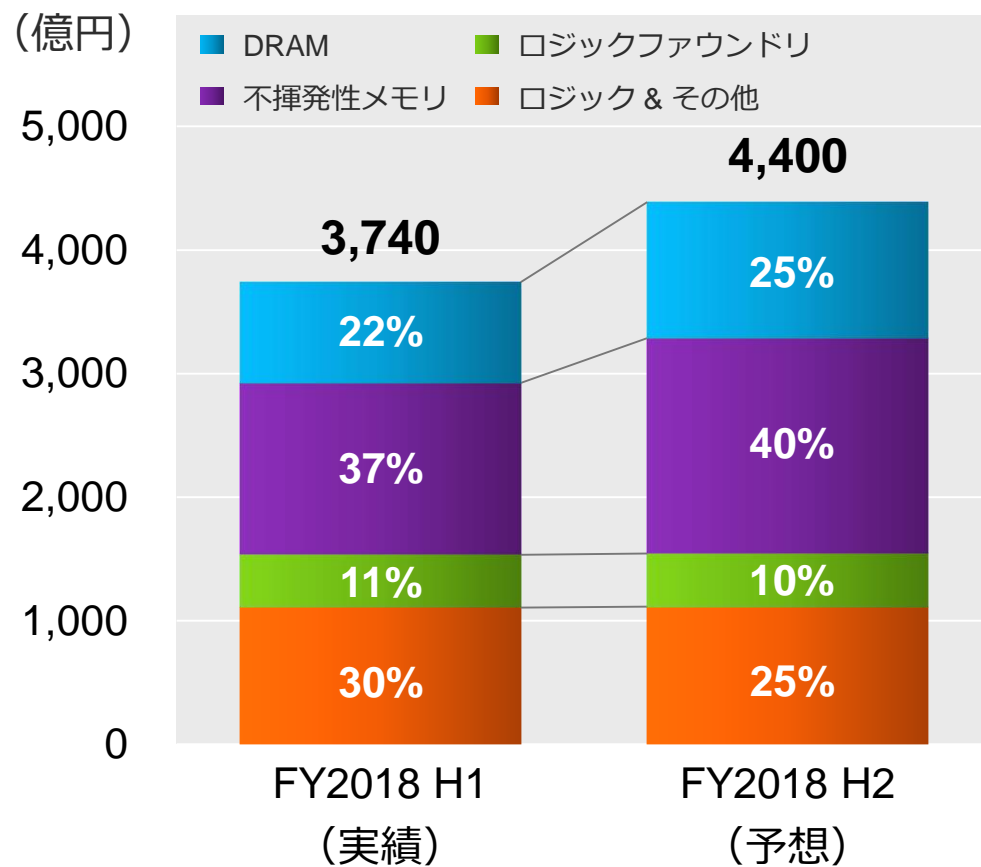
投資拡大とシェア向上により、通期業績予想を大幅に上方修正

*修正額：2017/4/28に発表した業績予想からの修正額を示しています。

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

FY2018 SPE部門 新規装置売上予想

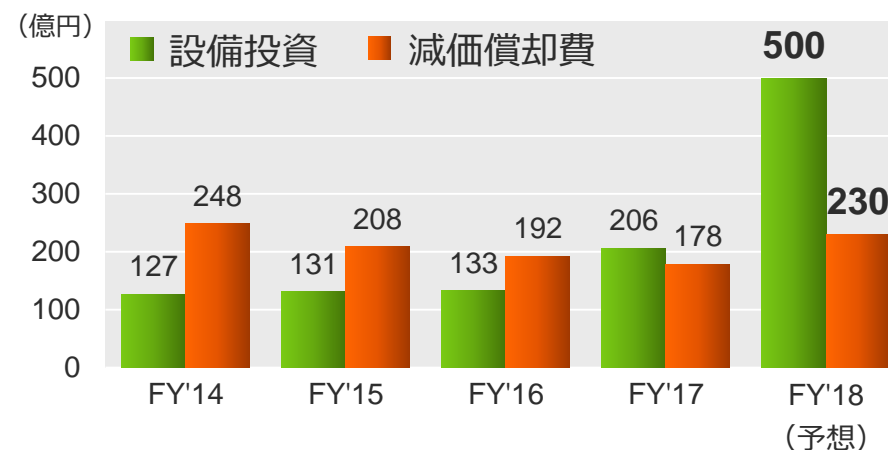
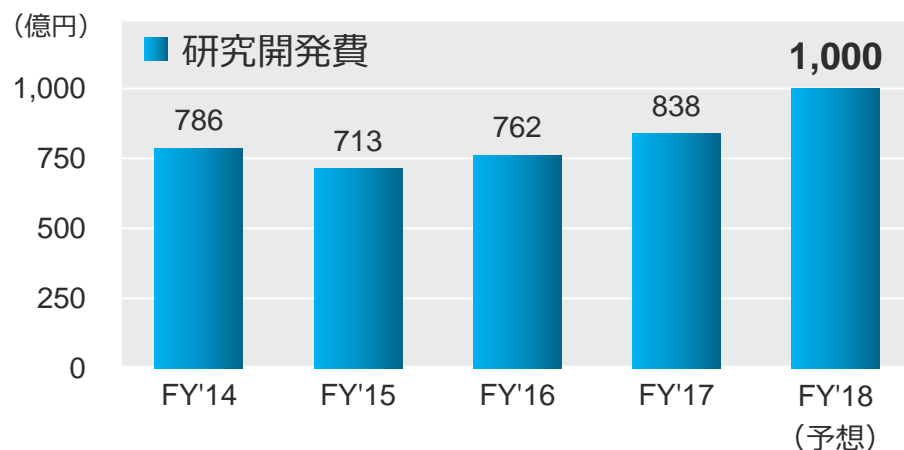
アプリケーション別売上構成比



- DRAM
 - 需給タイトにより投資急拡大
- 3D NAND
 - SSD向け需要好調、想定以上の投資拡大
 - 次世代9X向け装置の納入開始
- ロジック/ファウンドリ
 - 10/7nm世代への投資継続
 - 28nm世代以前への投資も堅調

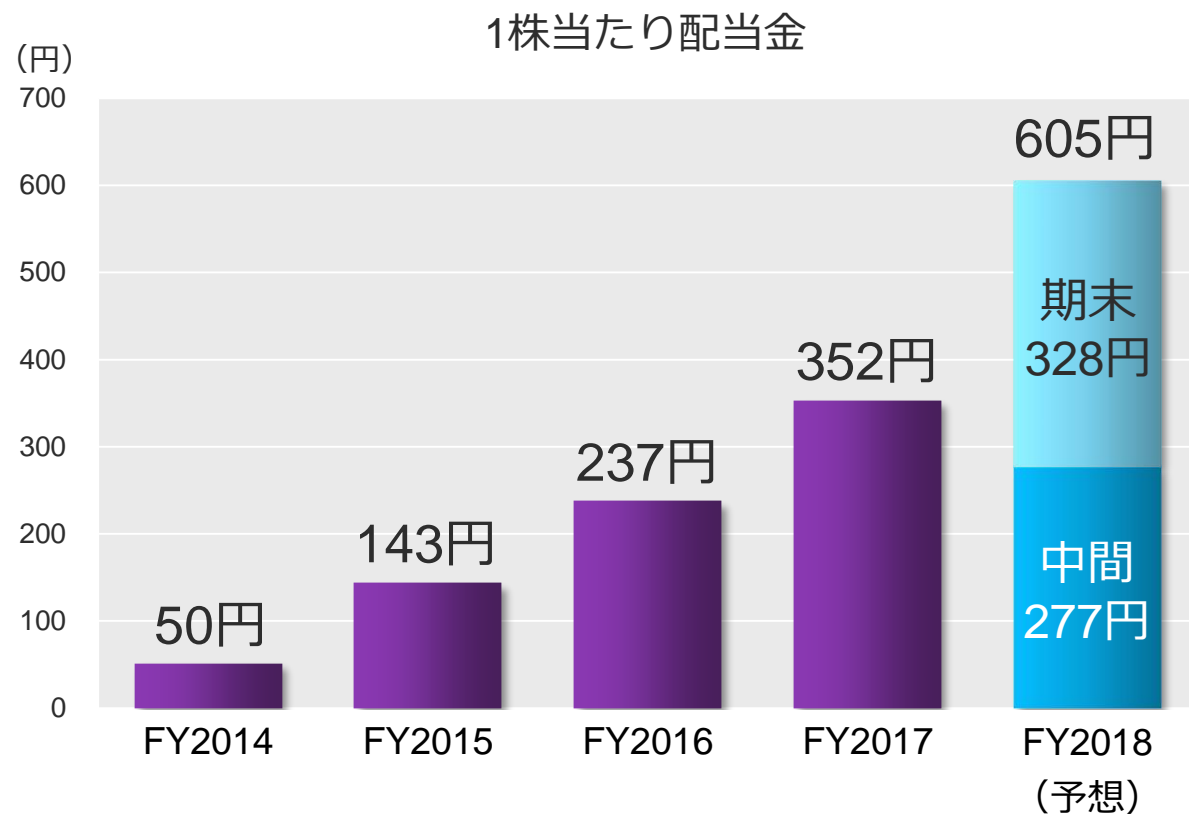
FY2018 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 940億円⇒1,000億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 420億円⇒500億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 240億円⇒230億円



装置市場の新たなフェーズに向けた積極的な先行投資を予定

FY2018 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比70%以上の増配を予定

補足資料

FY2018 H1 (2017年4月~9月) ハイライト

- 売上は過去最高の5,169億円 (前年同期比+47%)
 - メモリ向けSPE新規装置の売上が約2倍
 - FS事業の売上が+23%の1,188億円
- 順調に利益率が向上
 - 売上総利益率は前年同期比+2.4ptsの41.7%
 - 営業利益率は過去最高の23.9% (前年同期比+6.9pts)
中期目標の24%~26%が視野に入る
- 旺盛な半導体需要を背景に、通期売上・利益計画を上方修正

SPE : 半導体製造装置、FS : フィールドソリューション

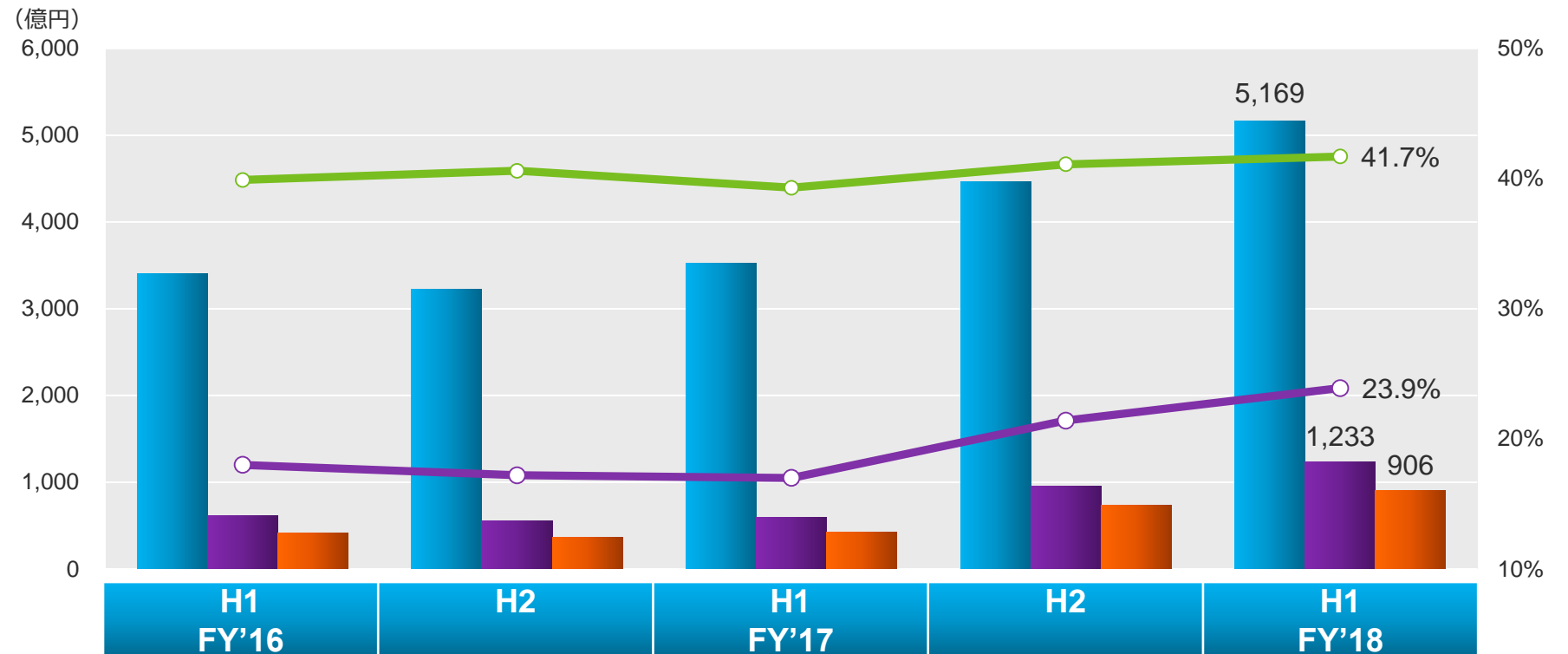
損益状況

(億円)

	FY2017		FY2018	対前年H1 増減率	(ご参考) 4月28日発表の FY2018 H1予想
	H1	H2	H1		
売上高	3,527	4,469	5,169	+46.6%	4,800
売上総利益 下段：売上総利益率	1,386 39.3%	1,836 41.1%	2,154 41.7%	+55.3% +2.4pts	2,020 42.1%
販管費	786	879	920	+17.1%	980
営業利益 下段：営業利益率	600 17.0%	956 21.4%	1,233 23.9%	+105.5% +6.9pts	1,040 21.7%
税前利益	544	946	1,223	+124.8%	1,040
親会社株主に帰属する 当期純利益	419	732	906	+116.1%	790
研究開発費	398	439	460	+15.7%	
設備投資額	94	112	198	+110.8%	
減価償却費	81	96	90	+10.1%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

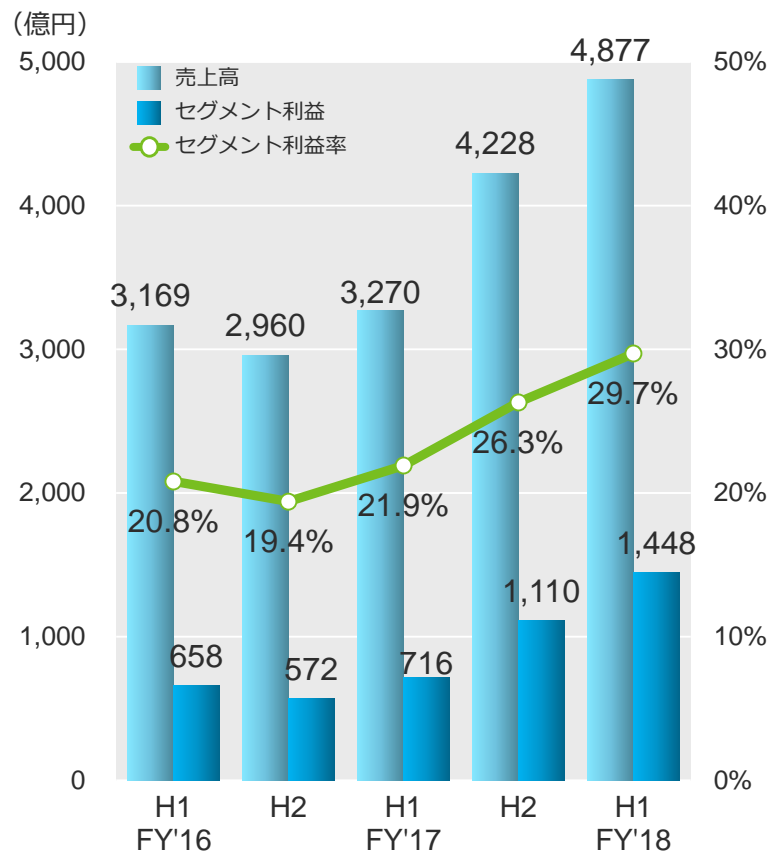
損益状況



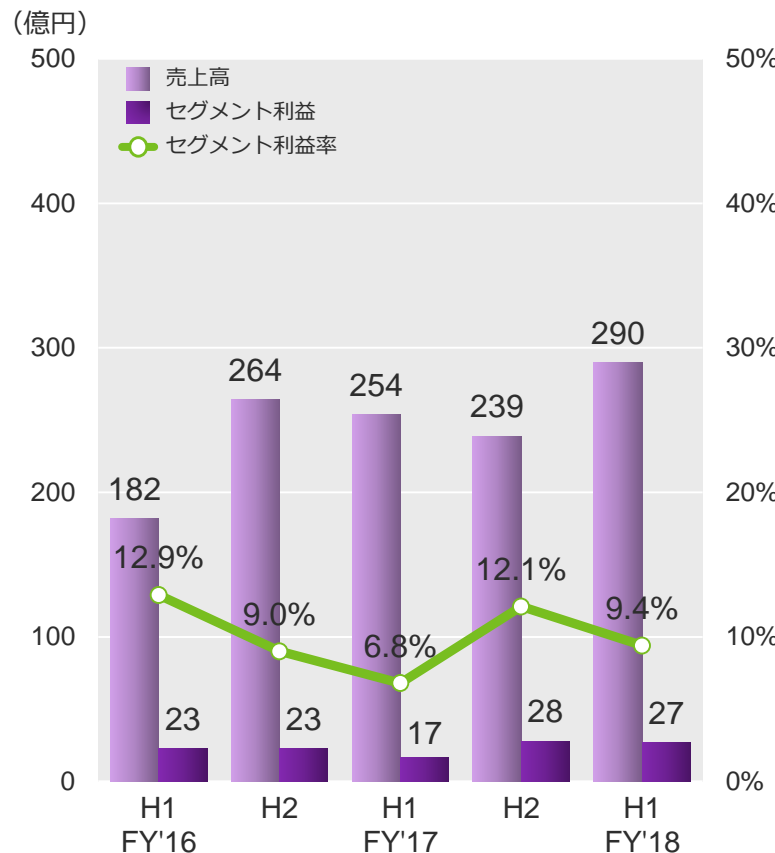
売上高	3,409	3,229	3,527	4,469	5,169
営業利益	612	555	600	956	1,233
親会社株主に帰属する 当期純利益	413	365	419	732	906
売上総利益率	39.9%	40.6%	39.3%	41.1%	41.7%
営業利益率	18.0%	17.2%	17.0%	21.4%	23.9%

セグメント情報

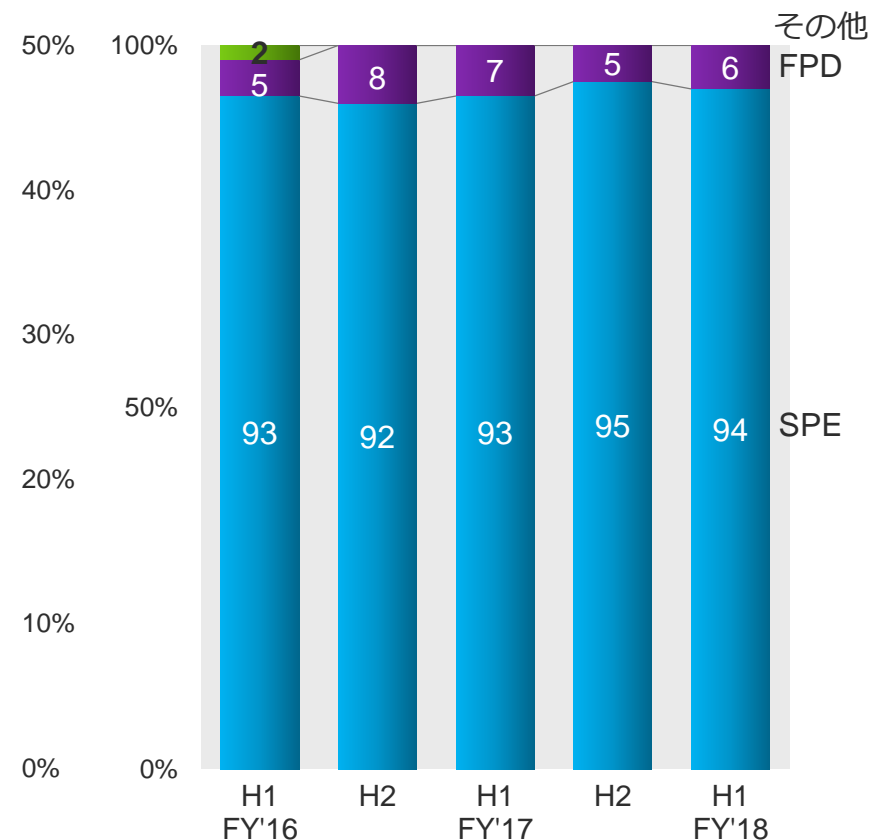
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



売上構成比率

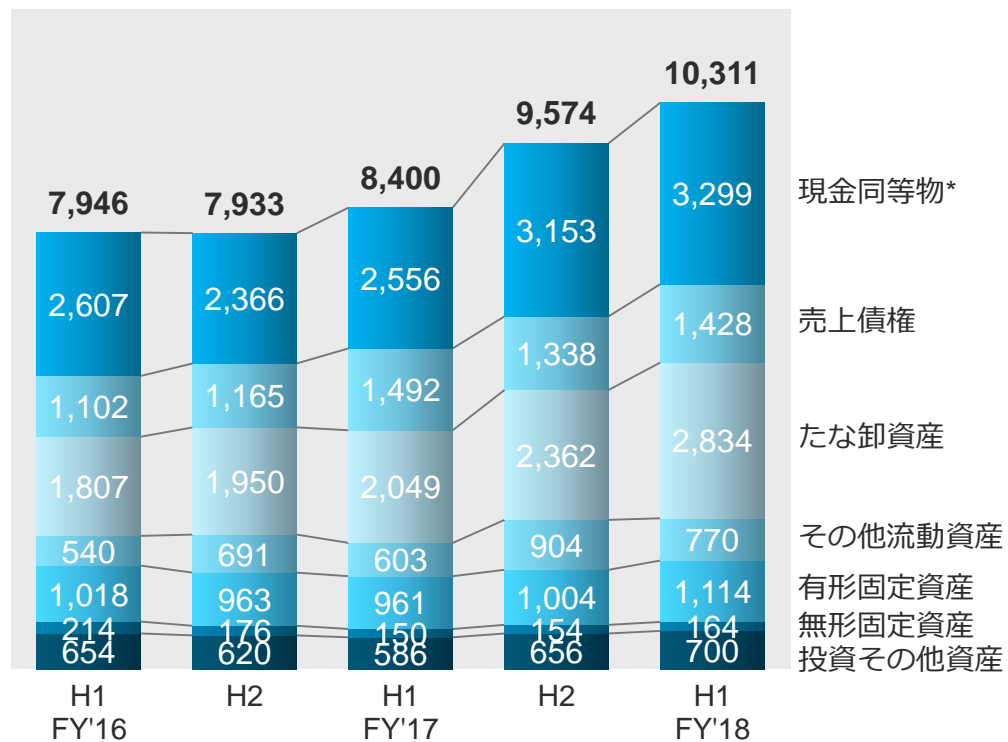


1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

貸借対照表

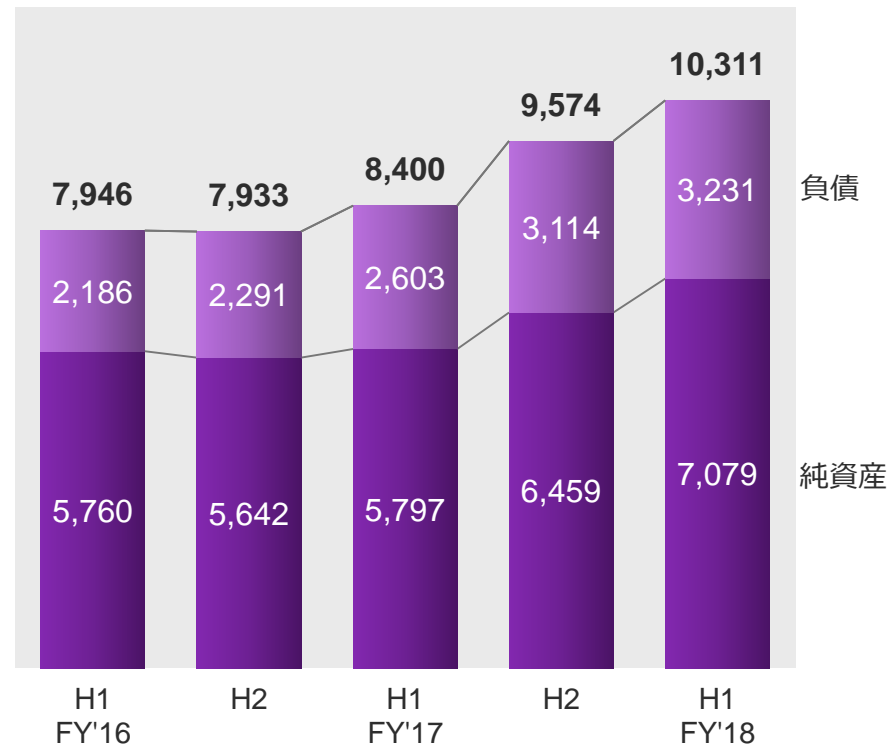
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

TEL™

TOKYO ELECTRON